

第 47 回 電子デバイス実装研究委員会

日時：2024 年 5 月 14 日（火） 13:00～16:50

場所：日本橋ライフサイエンスビルディング 9 階 911-913 会議室（東京都中央区）

プログラム

司会 小林 竜也（群馬大学）

13:00～13:10 委員会議事

13:10～13:20 Mate2024 シンポジウム 萌芽研究賞および優秀発表賞 表彰式

13:20～14:00

Mate2024 優秀論文賞受賞記念講演

『Sn-Bi-Zn-In 合金の微細組織が変形挙動に及ぼす影響』（40 分）

..... 中脇 啓貴^{*1}、巽 裕章^{*1}、Yang Chih-han^{*2}、Lin Shih-kang^{*2}、○西川 宏^{*1}
（^{*1} 大阪大学、^{*2} 国立成功大学）

14:00～14:40

Mate2024 萌芽研究賞受賞記念講演

『はんだ中への電極溶解を抑止可能な Mo バリア電極の耐衝撃性』（40 分）

..... ○前田 和孝、豊田 大介、三澤 卓（京セラ(株)）

14:40～14:50 休憩

司会 渡邊 裕彦（富士電機(株)）

14:50～15:30

『カーボンニュートラルに貢献する低温はんだソリューション MILATERA』（40 分）

..... ○岡 直正、北沢 和也、永井 智子、鶴飼 竜史、森 丞太郎、宗里 日南子（千住金属工業(株)）

15:30～16:10

『高信頼 SnBi 系低融点はんだ合金および低温はんだ付けプロセス開発』（40 分）

..... ○西村 貴利（(株)日本スペリア社）

16:10～16:50

『自動車端子向け高性能錫めっきの紹介』（40 分）

..... ○上田 雄太郎、鶴 将嘉、三井 俊幸（(株)神戸製鋼所）

（ ） 内時間は、質疑応答時間を含む

※プログラムは、都合により若干変更になることがありますので、予めご了承下さい。
※本研究委員会の資料を無断で転載、引用することを禁止します。
一般社団法人スマートプロセス学会 エレクトロニクス生産科学部会